

ALPHA[®] HITECH[™] CU31-3100

高耐热、低膨胀系数底部填充剂

概述


ALPHA HiTech CU31-3100 一种单组份毛细底部填充剂，设计用于保护印刷电路板上芯片封装的组装。

请在使用本产品前详细阅读技术数据说明书

特性与优点

- 低粘度，保证快速高效的流动性
- 低吸湿性释放大面积应力，主应力是元件和基板之间的热膨胀系数（CTE）的不匹配
- 高玻璃转化温度
- 低热膨胀系数
- 无卤素
- 符合 RoHS 指令 2011/65/EU

应用指南

存储	解冻	应用	固化
1. 存放温度 < -20 °C，以保证产品稳定。 2. 垂直放置，尖端朝下 	- 从冰箱中取出产品 - 放置在室温条件下 2 小时 - 产品完全解冻前不要开盖 - 产品解冻后不能重新冷冻 - 为防止未使用产品受到污染，不要将任何材料装回原包装中	ALPHA HiTech CU31-3100 可在室温条件下高效使用。	为保证充分固化，在 150 °C 条件下保持至少 7 分钟 (对流烘箱)

技术数据

类别	规格
未固化材料属性典型值	
外观	黑色
粘度 (RV DV-II Brookfield #5, 20 rpm @25°C)	3,000 – 8,000cps
比重	1.35 -1.45
闪点	>200 °C
使用期@ 25°C	3 天
保质期< -20°C	6 个月
包装规格	10cc, 30cc, 50cc 针筒装
固化后材料属性典型值	
玻璃化转变温度 (T _g) , TMA 方法	120 ± 5°C
热膨胀系数 (CTE, α ₁ , <T _g)	49 ± 10 ppm
热膨胀系数 (CTE, α ₂ , >T _g)	144 ± 20 ppm
硬度(Shore D)	80 – 90

安全&警告

建议贵公司产线操作员工在使用产品之前阅读并回顾产品安全技术说明书中关于健康和安全警告部分。请浏览 AlphaAssembly.com 以获得产品安全技术说明书。

联络资讯

请联络 Assembly@MacDermidAlpha.com 以确认此为最新发行版

www.macdermidalpha.com

<p>North America 300 Atrium Drive Somerset, NJ 08873, USA 800.367.5460</p>	<p>Europe Unit 2, Genesis Business Park Albert Drive Woking, Surrey, GU21 5RW, UK 01483.758400</p>	<p>Asia 8/F., Paul Y. Centre 51 Hung To Road Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong 852.3190.3100</p>
---	---	---

另请仔细阅读安全技术说明书中的警告和安全信息。本说明书包含安全、经济地操作本产品所需的技术信息。在产品使用之前彻底阅读。紧急安全协助电话：美国 1 202 464 2554，欧洲 + 44 1235 239670，亚洲 + 65 3158 1074。巴西 0800 707 7022 和 0800 172 020，墨西哥 01800 002 1400 和 (55) 5559 1588。

免责声明：本说明书所载之声明、技术信息和建议均基于我们认为可靠的测试，但不保证其准确性或完整性。除非卖方和制造商的高级职员签署的协议文件另有规定，否则任何声明或建议均不构成陈述。本说明书不为任何特定目的之适销性或适合性做出保证或任何默示保证。以下保证取代此类保证及所有其他明示、暗示或法定保证，产品在销售时，保证无材料和工艺技术上的缺陷。卖方及制造商在此保证下的唯一责任是更换销售时有缺陷的产品。在任何情况下，制造商或卖方皆免于承担因不能使用该产品所产生的任何直接或间接损失、损害或费用、偶然或后果性的损失。尽管上文另有规定，若产品系因应客户指定了超出上述参数的操作参数而提供的，或产品在超出上述参数的条件下使用的，则接受或使用该产品的客户承担因在此类条件下使用产品可能导致的所有产品故障风险及直接、间接及后果损失的全部风险，并同意使 **MacDermid Incorporated** 及其相关企业对此免责，并不负任何赔偿责任。产品使用的任何建议或此处包含的任何内容均不得解释为建议以侵犯任何专利或其他知识产权的方式使用任何产品，并且卖方和制造商对此类侵权不承担任何责任或义务。

© 2019 MacDermid, Inc 及其集团附属公司版权所有。标识有“(R)”和“TM”是MacDermid, Inc及其集团附属公司在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。